

平成20年10月15日

各 位

会 社 名 東京応化工業株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 中村洋一  
コード番号 4186（東証第一部）

**300mmウエハハンドリングシステム「ゼロニュートン®」量産装置を製品化**  
**300mmウエハへの貫通電極形成を容易に実現**

東京応化工業株式会社（本社：川崎市中原区／社長：中村洋一）は、貫通電極形成用ウエハハンドリングシステム「ゼロニュートン®」に対応した300mmシリコンウエハ用量産装置「TWM12000シリーズ／TWR12000シリーズ」を製品化したため、お知らせいたします。

当社のウエハハンドリングシステム「ゼロニュートン®」は、半導体パッケージ分野において次世代を担うキー・テクノロジーの1つと期待される貫通電極形成プロセスの実現に不可欠な技術で、シリコンウエハの極薄化に伴う強度の低下により割れや欠けが生じるという大きな課題を、シリコンウエハにガラス製サポート板を貼り付け強度を持たせることにより解決し、貫通電極形成を可能にする画期的なものです。

貫通電極形成後は、サポート板にある無数の穴から溶剤を染み込ませて仮止剤を溶解することにより、ストレスを与えることなくシリコンウエハとサポート板を分離させることができます。

当社がこのたび新たに製品化した装置は、このウエハハンドリングシステム「ゼロニュートン®」に対応したガラス製サポート板の貼付装置（「TWM12000シリーズ」）ならびに分離装置（「TWR12000シリーズ」）で、いずれも300mmシリコンウエハ用となっております。

当社では、すでに200mmシリコンウエハ用の貼付装置（「TWM8000シリーズ」）ならびに分離装置（「TWR8000シリーズ」）を製品化しておりましたが、「TWM12000シリーズ／TWR12000シリーズ」では、仮止剤の塗布性能を高めることでシリコンウエハとガラス製サポート板のホールド性を高め、また、貼り合わせ精度の向上、高スループット化を実現するなど、より高いパフォーマンスが可能となりました。さらに、シリコンウエハからサポート板を分離する際に発生する不純物を洗浄除去する機能を備えるなど、高機能化も図られております。

技術革新の進むエレクトロニクス機器分野では、搭載される半導体部品の小型・軽量化と高機能化が必須となっておりますが、貫通電極形成プロセスは、半導体チップを平面に並べる従来の技術に代わり、半導体チップを3次的に立体積層構造にすることで、さらなる高集積化・超小型化を可能にするもので、今後、需要は飛躍的に増大していくものと期待されております。

当社は、これまで培ってきた微細加工技術を活かし、ウエハハンドリングシステム「ゼロニュートン®」に対応した装置のほか、貫通電極形成プロセスに必要なフォトレジスト材料、ガラス製サポート板「WSPシリーズ」、仮止剤「TZNR-Aシリーズ」といった関連部材も併せ製品化するなど、材料と装置の両面から製品開発に取り組み、幅広く製品ラインアップを充実させ、ソリューションをご提供することにより、市場のご要望に応えてまいります。

なお、「TWM12000シリーズ／TWR12000シリーズ」は、当社湘南テクニカルセンター（神奈川県高座郡寒川町）において、お客様向けのデモンストレーションを随時実施しております。



貼付装置「TWM12000シリーズ」



分離装置「TWR12000シリーズ」

◆ 報道担当・お問い合わせ先  
(お問い合わせ先)

営業本部 営業開発室 (担当 種市)  
TEL : 044-435-3001 FAX : 044-435-3021

(報道担当)

広報部 (担当 萩原)  
TEL : 044-435-3000 FAX : 044-435-3020

以 上